

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-226296

(P2002-226296A)

(43)公開日 平成14年8月14日(2002.8.14)

(51)Int.Cl.⁷

C 3 0 B 29/06

識別記号

5 0 2

F I

C 3 0 B 29/06

テマコート* (参考)

5 0 2 J 4 G 0 7 7

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 7 頁)

(21)出願番号 特願2001-24520(P2001-24520)

(22)出願日 平成13年1月31日(2001.1.31)

(71)出願人 000190149

信越半導体株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

(72)発明者 桜田 昌弘

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平

150番地 信越半導体株式会社半導体白河
研究所内

(72)発明者 三田村 伸晃

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平

150番地 信越半導体株式会社半導体白河
研究所内

(74)代理人 100102532

弁理士 好宮 幹夫

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 シリコン単結晶の製造方法

(57)【要約】

【課題】 育成されたシリコン単結晶をスライスしてウエーハとした時に、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよびLEP欠陥が観察されないような無欠陥シリコン単結晶をより安定した製造条件下に製造する。

【解決手段】 チョクラルスキー法によるシリコン単結晶の製造方法において、育成されたシリコン単結晶をスライスしてウエーハとした時に、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよびL/D欠陥が観察されない領域で結晶を育成するとともに、成長結晶が空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯を通過する時の平均冷却速度が1℃/min以上となるように制御して育成することを特徴とするシリコン単結晶の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 チョクラスキー法によるシリコン単結晶の製造方法において、育成されたシリコン単結晶をスライスしてウェーハとした時に、ウェーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよびL/D欠陥が観察されない領域で結晶を育成するとともに、成長結晶が空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯を通過する時の冷却速度の平均値が1℃/min以上となるように制御して育成することを特徴とするシリコン単結晶の製造方法。

【請求項2】 前記通過時間を制御するボイド欠陥を形成する温度帯を1080～1150℃とすることを特徴とする請求項1に記載したシリコン単結晶の製造方法。

【請求項3】 シリコン単結晶に窒素をドーピングする時は、前記通過時間を制御するボイド欠陥を形成する温度帯を990～1050℃とすることを特徴とする請求項1に記載したシリコン単結晶の製造方法。

【請求項4】 請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の方法により育成されたことを特徴とするシリコン単結晶。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、チョクラスキー法によるシリコン単結晶育成において、ウェーハ全面にOSF、FPD、L/D等の成長欠陥が極めて少ないシリコン単結晶を高歩留りで製造する方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年は、半導体回路の高集積化に伴う素子の微細化に伴い、その基板となるチョクラスキー法（以下、CZ法と略記する）で作製されたシリコン単結晶に対する品質要求が高まってきている。特に、FPD、LSTD、COP、L/D等のグローニン（Grow-in）欠陥と呼ばれる酸化膜耐圧特性やデバイスの特性を悪化させる、単結晶成長起因の欠陥が存在しその密度とサイズの低減が重要視されている。

【0003】これらの欠陥を説明するに当たって、先ず、シリコン単結晶に取り込まれるベikanシイ（Vacancy、以下Vと略記することがある）と呼ばれる空孔型の点欠陥と、インターstitialシリコン（Interstitial-Si、以下Iと略記することがある）と呼ばれる格子間型シリコン点欠陥のそれぞれの取り込まれる濃度を決定する因子について、一般的に知られていることを説明する。

【0004】シリコン単結晶において、V領域とは、Vacancy、つまりシリコン原子の不足から発生する凹部、穴のようなものが多い領域であり、その実態は空孔の凝集体である八面体のボイド状欠陥といわれている。一方I領域とは、シリコン原子が余分に存在することにより発生する転位や余分なシリコン原子の塊が多い

領域のことであり、そしてV領域とI領域の間には、原子の不足や余分が無い（少ない）ニュートラル（Neutral、以下Nと略記することがある）領域が存在していることになる。そして、前記グローニン欠陥（FPD、LSTD、COP、L/D等）というのは、あくまでもVやIが過飽和な状態の時に発生するものであり、多少の原子の偏りがあっても、飽和以下であれば、欠陥としては存在しないことが判ってきた。

【0005】この両点欠陥の濃度は、CZ法における結晶の引上げ速度（成長速度）と結晶中の固液界面近傍の温度勾配Gとの関係から決まり、V領域とI領域との境界近辺にはOSF（酸化誘起積層欠陥、Oxidation Induced Stacking Fault）と呼ばれる欠陥が、結晶成長軸に対する垂直方向の断面で見た時に、リング状に分布（以下、OSFリングということがある）していることが確認されている。

【0006】そしてこれら結晶成長起因の欠陥を分類すると、例えば成長速度が0.6mm/min前後以上と比較的高速の場合には、空孔タイプの点欠陥が集合したボイド起因とされているFPD、LSTD、COP等のグローニン欠陥が結晶径方向全域に高密度に存在し、これら欠陥が存在する領域はV領域と呼ばれている。また、成長速度が0.6mm/min以下の場合には、成長速度の低下に伴い、OSFリングが結晶の周辺から発生し、このリングの外側に格子間シリコンによる転位ループ起因と考えられているL/D（Large Dislocation：格子間転位ループの略号、LSEPD、LFPD等）の欠陥が低密度に存在し、これら欠陥が存在する領域はI領域（L/D領域ということがある）と呼ばれている。さらに、成長速度を0.4mm/min前後以下と低速にすると、OSFリングがウェーハの中心に凝集して消滅し、全面がI領域となる。このI領域にある欠陥は、LEP（Large Etch Pit）とか転位クラスタとも呼ばれている。

【0007】また、近年V領域とI領域の間でOSFリングの外側に、N領域と呼ばれる、空孔起因のFPD、LSTD、COPも、転位ループ起因のLSEPD、LFPDも存在しない領域の存在が発見されている。この領域はOSFリングの外側にあり、そして、酸素析出熱処理を施し、X-ray観察等で析出のコントラストを確認した場合に、酸素析出がほとんどなく、かつ、LSEPD、LFPDが形成されるほどリッチではないI領域側であると報告されている。

【0008】これらのN領域は、通常の方法では、成長速度を下げた時に成長軸方向に対して斜めに存在するため、ウェーハ面内では一部分にしか存在しなかった。このN領域について、ボロコフ理論（V. V. Voronkov; Journal of Crystal Growth, 59 (1982) 625～643）では、引上げ速度（V）と結晶固液界面軸方向温度勾配（G）

の比である V/G というパラメータが点欠陥のトータルな濃度を決定すると唱えている。このことから考えると、面内で引上げ速度は一定のはずであるから、面内で G が分布を持つために、例えば、ある引上げ速度では中心が V 領域で N 領域を挟んで周辺で I 領域となるような結晶しか得られなかった。

【0009】そこで最近、面内の G の分布を改良して、このウエーハ面内では一部分にしか存在しなかった N 領域を、例えば、引上げ速度 V を徐々に下げながら引上げた時に、ある引上げ速度で N 領域が横全面に広がった結晶が製造できるようになった。また、この全面 N 領域の結晶を長さ方向へ拡大するには、この N 領域が横に広がった時の引上げ速度を維持して引上げればある程度達成できる。また、結晶が成長するに従って G が変化することを考慮し、それを補正して、あくまでも V/G が一定になるように、引上げ速度を調節すれば、それなりに成長方向にも、全面 N 領域となる結晶が拡大できるようになった。

【0010】しかし、この全面 N 領域で単結晶を育成する場合、その引上げ速度マージン（制御範囲）は、 $\Delta V \approx 0.02 \text{ mm/min}$ 程度と非常に狭いもので（J. G. Park, 日本結晶成長学会誌vol. 27, 2000, pp14）、わずかな引上げ速度の変動でグローイン欠陥が発生し、安定した引上げが困難であり、歩留りが低く、その改善が望まれていた。

【0011】一方、上記 N 領域をさらに分類すると、OSFリングの外側に隣接する N_v 領域（空孔の多い領域）と I 領域に隣接する N_i 領域（格子間シリコンが多い領域）とがあり、 N_v 領域では、熱酸化処理した際に酸素析出量が多く、 N_i 領域では酸素析出が殆ど無いことがわかってきた。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、このような問題点を鑑みてなされたもので、育成されたシリコン単結晶をスライスしてウエーハとした時に、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよび L/D 欠陥が観察されないような無欠陥シリコン単結晶をより安定した製造条件下に得ることを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達成するために為されたもので、本発明に係るシリコン単結晶の製造方法は、チョクラスキー法によるシリコン単結晶の製造方法において、育成されたシリコン単結晶をスライスしてウエーハとした時に、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよび L/D 欠陥が観察されない領域で結晶を育成するとともに、成長結晶が空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯を通過する時の冷却速度の平均値が 1°C/min 以上となるように制御して育成することを特徴としている（請求項1）。

【0014】このように、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよび L/D 欠陥が観察されない領域で所定の V/G 値を保ちつゝ結晶を育成するとともに、空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯を通過する時の平均冷却速度を 1°C/min 以上で急冷すれば、OSFリングの外側に存在する N 領域あるいは N_v 領域が拡大し、結晶の引上げ速度のマージンが大巾に拡大し、歩留りが向上するという効果を得ることができる。

【0015】この場合、通過時間を制御するボイド欠陥を形成する温度帯を $1080 \sim 1150^\circ\text{C}$ とすることが好ましい（請求項2）。このように、成長結晶の $1080 \sim 1150^\circ\text{C}$ の温度帯を急冷すれば、ボイド欠陥凝集体のサイズが徐冷に比べ縮小する。特にこの温度帯の通過時間を70分以下にして冷却速度の平均値を 1°C/min 以上にすると凝集体のサイズ縮小効果が極めて大きく、所定の V/G の値で引上げたときの N 領域の拡大効果も大きい。従って、結晶欠陥のないシリコン単結晶を安定して得ることができる。

【0016】また、シリコン単結晶に窒素をドーピングする時は、前記ボイド欠陥を形成する温度帯を $990 \sim 1050^\circ\text{C}$ とすることが好ましい（請求項3）。このように、シリコン単結晶に窒素をドーピングする時は、前記ボイド欠陥を形成する温度帯が、窒素をドーピングしない場合の $1080 \sim 1150^\circ\text{C}$ から $990 \sim 1050^\circ\text{C}$ にシフトするので、この温度帯での結晶の平均冷却速度を 1°C/min 以上にして急冷すると、所定の V/G の値で引上げたときの N 領域が拡大するとともに、ボイド欠陥凝集体のサイズが徐冷に比べ著しく縮小し、結晶欠陥のないシリコン単結晶を得ることができる。

【0017】さらに、本発明によれば、前記製造方法により育成されたことを特徴とするシリコン単結晶が提供される（請求項4）。本発明の製造方法によれば、育成されたシリコン単結晶をスライスしてウエーハとした時に、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよび L/D 欠陥が観察されないシリコン単結晶を安定した製造条件下で高い歩留りをもって育成することができる。

【0018】以下、本発明につき詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。説明に先立ち各用語につき予め解説しておく。

1) FPD (Flow Pattern Defect) とは、成長後のシリコン単結晶棒からウエーハを切り出し、表面の歪み層を弗酸と硝酸の混合液でエッチングして取り除いた後、 $K_2Cr_2O_7$ と弗酸と水の混合液で表面をエッチング（Seccoエッチング）することによりピットおよびさざ波模様が生じる。このさざ波模様をFPDと称し、ウエーハ面内のFPD密度が高いほど酸化膜耐圧の不良が増える（特開平4-192345号公報参照）。

【0019】2) SEPD (Secco Etch Pit Defect) とは、FPDと同一のSeccoエッチングを施した時に、流れ模様 (flow pattern) を伴うものをFPDと呼び、流れ模様を伴わないものをSEPDと呼ぶ。この中で10 μ m以上の大きいSEPD (LSEPD) は転位クラスターに起因すると考えられ、デバイスに転位クラスターが存在する場合、この転位を通じて電流がリークし、P-Nジャンクションとしての機能を果たさなくなる。

【0020】3) LSTD (Laser Scattering Tomography Defect) とは、成長後のシリコン単結晶棒からウエーハを切り出し、表面の歪み層を弗酸と硝酸の混合液でエッチングして取り除いた後、ウエーハを劈開する。この劈開面より赤外光を入射し、ウエーハ表面から出た光を検出することでウエーハ内に存在する欠陥による散乱光を検出することができる。ここで観察される散乱体については学会等ですでに報告があり、酸素析出物とみなされている (Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 32, P3679, 1993参照)。また、最近の研究では、八面体のボイド (穴) であるという結果も報告されている。

【0021】4) COP (Crystal Originated Particle) とは、ウエーハの中心部の酸化膜耐圧を劣化させる原因となる欠陥で、SeccoエッチではFPDになる欠陥が、SC-1洗浄 (NH₄OH:H₂O₂:H₂O=1:1:10の混合液による洗浄) では選択エッチング液として働き、COPになる。このピットの直径は1 μ m以下で光散乱法で調べ

る。

【0022】5) L/D (Large Dislocation: 格子間転位ループの略号) には、LSEP、LFDP等があり、格子間シリコンによる転位ループ起因と考えられている欠陥である。LSEPDは、上記したようにSEPDの中でも10 μ m以上の大きいものをいう。また、LFDPは、上記したFPDの中でも先端ピットの大きさが10 μ m以上の大きいものをいい、こちらも転位ループ起因と考えられている。

【0023】

【発明の実施の形態】本発明者らは、CZ法によるシリコン単結晶成長に関し、V領域とI領域の中間でOSFリングの外側にある、FPD、LSTD、COPの数が著しく少なく、L/Dも存在しないニュートラルなN領域で結晶を育成する場合に、この領域内となるように制御できる範囲を拡大することを検討した。

【0024】空孔点欠陥が凝集体を形成する温度帯は、報文により多少のバラツキが見られるが、1080~1150℃に代表される (K. Takano et al., Mat. Sci. Forum, 196, p1707, 1995; R. Falster et al.,

Semiconductor Silicon 1998; The Electrochemical Society Proceeding Series, p468, 1998; T. Saishoji et al., High Purity Silicon V, The Electrochemical Society Proceeding Series, p28, 1998)。

【0025】この温度帯を結晶が通過する時間を短くすると、ボイドに起因するCOPやFPD等のグローイン欠陥密度は増大するがサイズが縮少することが知られている (K. Takano et al., Mat. Sci. Forum, 196, p1707, 1995)。このことを利用し、急冷により空孔点欠陥の凝集体のサイズを縮小し、OSF外側のN領域を形成できる引上げ速度の範囲を拡大することができるのではないかと発想した。

【0026】まず本発明で使用した単結晶育成装置の構成例を図1により説明する。図1に示した単結晶育成装置は、一般的な単結晶育成装置と同様、原料、例えば原料融液4を収容するルツボ5、6、多結晶シリコン原料を加熱、熔融するためのヒータ7などがメインチャンバ1内に格納され、メインチャンバ1上に連設された引上げチャンバ2の上部には、育成された単結晶を引上げる引上げ機構 (図示せず) が設けられている。引上げチャンバ2の上部に取り付けられた引上げ機構 (不図示) からはワイヤ16が巻き出されており、その先端には種結晶17を取り付けるための種ホルダ18が接続され、種ホルダ18の先に取り付けられた種結晶17を原料融液4に浸漬し、ワイヤ16を引上げ機構によって巻き取ることで種結晶17の下方に単結晶棒3を形成する。

【0027】なお、上記ルツボ5、6は、内側に原料融液4を直接収容する石英ルツボ5と、外側を該石英ルツボ5を支持するための黒鉛ルツボ6とから構成されている。ルツボ5、6は、単結晶育成装置20の下部に取り付けられた回転駆動機構 (図示せず) によって回転昇降動自在なルツボ回転軸19に支持されており、単結晶育成装置中の融液面の変化によって結晶品質が変わることのないよう、融液面を一定位置に保つため、結晶と逆方向に回転させながら単結晶棒3の引上げに応じて融液が減少した分だけルツボを上昇させている。

【0028】ルツボ5、6を取り囲むように加熱ヒータ7が配置されており、この加熱ヒータ7の外側には、ヒータ7からの熱がメインチャンバに直接輻射されるのを防止するための断熱部材8が周囲を取り囲むように設けられている。また、チャンバ1、2内部には、炉内に発生した不純物を炉外に排出する等を目的とし、引上げチャンバ2上部に設けられたガス導入口10からアルゴンガス等の不活性ガスが導入され、引き上げ中の単結晶棒3、融液4上部を通過してチャンバ1、2内部を流通

し、ガス流出口 9 から排出される。

【0029】本発明で使用される単結晶育成装置では、引上げ中の単結晶棒 3 を空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する所定の温度帯を強制冷却するために、冷却筒 11 が引上げ中の単結晶棒 3 を取り囲むように前記メインチャンバ 1 の少なくとも天井部から原料融液表面に向かって延伸している。この時、冷却筒 11 の上端は、取り付けの状況や炉内の温度分布によって引上げチャンバ内まで延長しても良い。

【0030】図 1 に示す単結晶育成装置 20 の冷却筒 11 内には、冷却媒体導入口 12 から冷却媒体が導入され、該冷却媒体は、冷却筒 11 内を循環して冷却筒 11 を強制冷却した後、外部へ排出される。なお、冷却媒体としては、従来冷却媒体として使用されている液体あるいは気体を使用することができるが、冷却特性のほか、取り扱い性、コスト面等からも水を使用するのが好適である。また、これら冷却筒 11 内に流す冷却媒体の流量や温度を必要に応じて調節すれば、冷却筒 11 の除去熱量を変化させることができるので、これにより成長単結晶の冷却速度を自在に制御することが可能である。

【0031】また、前記冷却筒 11 より下方に延伸し、円筒または下方に向かって縮径された形状の冷却補助部材を有している。図 1 の単結晶育成装置 20 では、前記冷却筒 11 の下端部から原料融液面近傍に延伸する円筒状の冷却補助部材 13 が設けられている。冷却補助部材 13 は、引上げられた直後の高温の単結晶 3 の周囲を囲んでおり、ヒータ 7 あるいは融液 4 等からの輻射熱を遮って単結晶 3 を冷却する効果を有する。また、冷却筒 11 が融液面の直上まで近づくことが防止され安全性が確保されるとともに、融液上方から結晶近傍を下流する不活性ガスの整流効果が発揮される。この冷却補助部材 13 の長さ、径、材質、下端から融液面までの間隔等を調整することによっても成長結晶の冷却速度を自在に制御できる。

【0032】以上のような本発明で使用される単結晶育成装置 20 は、前記のように冷却筒 11 と冷却補助部材 13 を組み合わせて設けることにより、融液 4 から成長した直後の非常に高温の単結晶 3 が、まず冷却補助部材 13 によってヒータ 7 等からの輻射熱が遮られて効果的に冷却され、単結晶 3 はさらに引上げられることで冷却筒 11 と相対し、少なくともメインチャンバ 1 の天井部まで冷却筒 11 により冷却されるので、結晶の広範囲にわたって効率良く冷却される。そのため、結晶からの流出熱量を確実に除去し、冷却効果を最大限に発揮するので、空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯を急速に冷却することができる。別に、最近ではメインチャンバ 1 の水平方向の外側に、図示しない磁石を設置し、シリコン融液 4 に水平方向あるいは垂直方向等の磁場を印加することによって、融液の対流を抑制し、単結晶の安定成長をはかる、いわゆる MCZ 法が用いられる

ことも多い。

【0033】(実験 1) 上記図 1 に示した HZ (ホットゾーン、炉内構造) を具備した MCZ 法単結晶育成装置 (横磁場印加) を使用し、24 インチ石英ルツボに原料多結晶シリコンを 150 kg チャージし、直径 8 インチ (直径 200 mm)、方位 <100> のシリコン単結晶を引上げた。

【0034】まず、冷却補助部材 13 の先端と湯面との間隔、冷却筒 11 の水量等を変化させることにより、成長結晶が 1080~1150℃ の温度帯を通過する時間、すなわち冷却速度の平均値を種々変更して、N 領域結晶を成長させた。引上げた単結晶のウエーハについて欠陥分布および欠陥サイズを求めた。その結果、引上げられた結晶には、OSF、FPD および L/D が観察されず、OSF 外側の N 領域結晶となっていることを確認した。

【0035】次に、上記装置を用いて単結晶を引上げる際、成長速度を 0.7 mm/min から 0.3 mm/min の範囲で結晶頭部から尾部にかけて漸減させるよう制御する漸減テストを実施し、1080~1150℃ の温度帯を通過する時間と成長速度マージン ΔV との関係求めた。ここで ΔV は OSF の発生しない上限の成長速度 V_{max} と L/D の発生しない下限の成長速度 V_{min} との差として、 $\Delta V = V_{max} - V_{min}$ で定義される。

【0036】以上の結果を図 2 (a) に示す。図 2 (a) から、引上げ成長速度 V を OSF 外側の N 領域を形成する条件を満たすように調節して引上げた場合、ボイド欠陥を形成する温度帯である 1080~1150℃ を通過する時間を変化させると、成長速度のマージンが大巾に変化し、70 分以下で急拡大することが解る。この時の結晶の平均冷却速度は 1℃/min 以上である。急冷の場合と徐冷の場合を比較すると約 4 倍の ΔV を達成したことになり、無欠陥領域の製造が容易となって歩留りを確実に増大させることが可能である。また、従来 OSF リングが発生する V/G 値は定数とされていた (W. von Ammon et al., Journal of Crystal Growth, vol. 151, p 273, 1995; M. Hourai et al., Semiconductor Silicon 1998, The Electrochemical Society Proceeding Series, p 453, 1998; 特開平 8-330316 号公報等)。しかし、今回の実験で V/G 値が結晶の冷却速度によって変化することが示唆される。

【0037】(実験 2) 格子間酸素が析出する温度帯といわれている 650~950℃ を通過する時間と成長速度マージンとの関係を実験 1 と同様の方法により求めた。その結果を図 2 (b) に示す。この図からわかるように、相関関係が弱く、低温領域の冷却速度は成長速度マージンを拡大する要素としては重要でないことがわか

る。なお、500分近傍の領域で、 ΔV が急拡大しているが、調査したところ、650～1150℃を500分程度までに急冷しようとする、1150～1080℃も急冷しないと、結晶の引上げが不可能であり、その影響であると考えられる。

【0038】本発明者等は、以上の実験で得られた知見を踏まえた上で、鋭意検討を重ね、本発明に想到したものである。本発明のシリコン単結晶の製造方法は、チョクラスキー法によるシリコン単結晶の製造方法において、育成されたシリコン単結晶をスライスしてウエーハとした時に、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよびL/D欠陥が観察されない領域で結晶を育成するとともに、結晶が空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯を通過する時の平均冷却速度が1℃/min以上となるように制御して育成することを特徴としている。

【0039】このように、ウエーハの全面内に少なくともOSF、FPDおよびL/D欠陥が観察されない領域で所定のV/G値を保ちつゝ結晶を育成するとともに、空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯を通過する時の平均冷却速度を1℃/min以上にして急冷すれば、OSFリングの外側に存在するN領域あるいはN_v領域が拡大し、結晶の引上げ速度のマージンが大巾に拡大し、安定成長が可能となって歩留りが向上するという効果を得ることができる。

【0040】そして、空孔点欠陥が凝集してボイド欠陥を形成する温度帯の通過時間の短縮（冷却速度の平均値の増加）は、その温度帯での平均温度勾配Gを増大させることにより達成される。大きなGの達成には結晶を包囲するような結晶冷却筒を具備したHZを用いればよい。空孔点欠陥凝集体を形成する温度帯の通過時間の調節は引上げ速度によっても達成される。しかし、引上げ速度はN領域形成の必要条件である成長界面でのV/Gの値により規定される場合が多いので各温度帯の通過時間はGにより調節するのが現実的である。

【0041】この場合、通過時間（冷却速度の平均値）を制御するボイド欠陥を形成する温度帯としては、1080～1150℃が選択されるが、シリコン単結晶に窒素をドーブする時は、前記ボイド欠陥を形成する温度帯を990～1050℃とすることが好ましい。シリコン単結晶に窒素をドーブすると、N領域が拡大するとともに、欠陥サイズが小さくなると言われている（M. Iida et al., High Purity Silicon V, The Electrochemical Society Series, p499, 1999）。そして、シリコン単結晶に窒素をドーブする時は、前記ボイド欠陥を形成する温度帯が、窒素をドーブしない場合の1080～1150℃から990～1050℃にシフトするので、この温度帯の通過時間を60分以下にして、すなわち冷却速度の平均値を1℃/min

以上として急冷すると、所定のV/Gの値で引上げたときのN領域が一層拡大するとともに、ボイド欠陥凝集体のサイズが一層縮小し、結晶欠陥のないシリコン単結晶を一層安定して製造することができる。ドーブする窒素濃度は 5×10^{15} 個/cm³以下とするのが良い。

【0042】

【実施例】以下、本発明の実施例と比較例を挙げて、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されることはない。

（実施例）上記図1に示した結晶冷却筒をもつHZを具備したMCZ法単結晶育成装置（横磁場印加）を使用し、24インチ石英ルツボに原料多結晶シリコンを150kgチャージし、直径8インチ（直径200mm）、方位<100>のシリコン単結晶を引上げた。この際、成長界面での温度勾配の半径方向の分布 ΔG を抑制し、成長速度VをV/GがOSF外側のN領域を形成するように調節した。このとき、1080～1150℃の温度帯を通過する時間は46分であり、冷却速度の平均値は1.5℃/minであった。また、前記と同様の成長速度漸減テストでは、成長速度マージンは $\Delta V = 0.076$ mm/minであった。

【0043】引上げた単結晶のウエーハについて欠陥分布および欠陥サイズを求めた。その結果、引上げられた結晶には、OSF、FPDおよびL/Dが観察されず、OSF外側のN領域結晶となっていることを確認した。

【0044】（比較例）上記1080～1150℃の温度帯を通過する時間を126分として徐冷した以外は、実施例と同様の条件でシリコン単結晶を引上げた。この場合、ボイド欠陥サイズの縮小は殆ど認められなかった。また成長速度漸減テストでは、通過時間=126分、冷却速度の平均値は0.56℃/minに対して成長速度マージンは $\Delta V = 0.018$ mm/minであった。

【0045】以上の結果、実施例では、従来法に比較して約4倍の成長速度マージンを達成していることがわかる。

【0046】なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

【0047】例えば、上記実施形態においては、直径8インチのシリコン単結晶を育成する場合につき例を挙げて説明したが、本発明はこれには限定されず、直径10～1.6インチあるいはそれ以上のシリコン単結晶にも適用できる。また、本発明は、シリコン融液に水平磁場、縦磁場、カスプ磁場等を印加するいわゆるMCZ法にも適用できることは言うまでもない。

【0048】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の

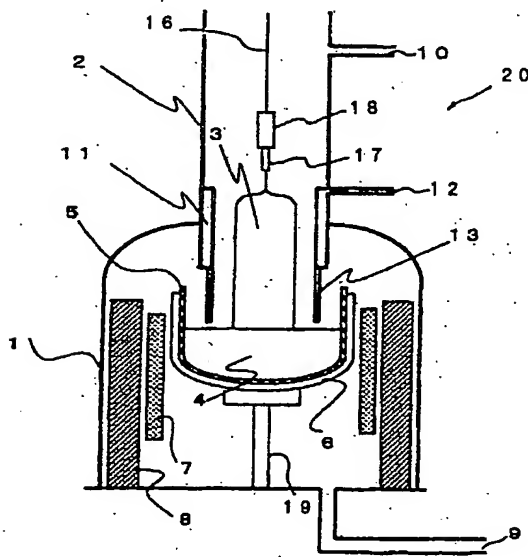
シリコン単結晶の製造方法によれば、OSFリングの外側に存在するN領域あるいはN_v領域が拡大し、結晶の引上げ速度のマージンが大巾に拡大し、安定成長が可能となる結果、歩留りの向上を図ることができる。さらに本発明の製造方法は、窒素ドーピングシリコン単結晶の育成にも適用でき、無欠陥窒素ドーピングシリコン単結晶を育成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で使用した単結晶育成装置の概略図である。

【図2】単結晶引上げ速度のマージンと成長単結晶の各

【図1】



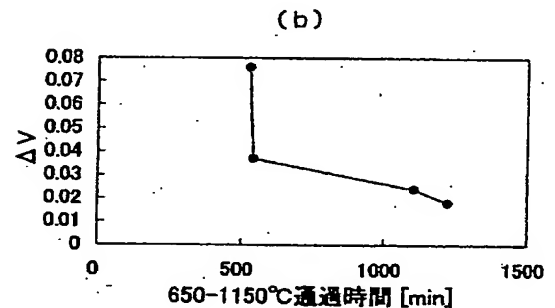
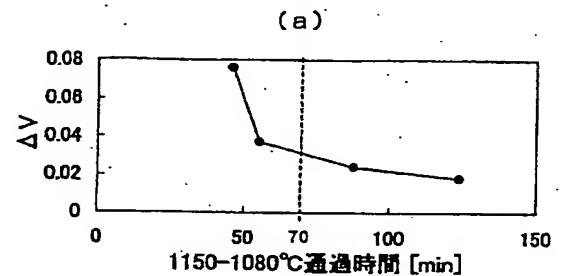
温度帯における通過時間の関係を示す関係図である。

(a) 1080~1150℃、(b) 650~1150℃。

【符号の説明】

1…メインチャンバ、2…引上げチャンバ、3…単結晶(棒)、4…原料融液、5…石英ルツボ、6…黒鉛ルツボ、7…ヒータ、8…断熱部材、9…ガス流出口、10…ガス導入口、11…冷却筒、12…冷却媒体導入口、13…冷却補助部材、14…ワイヤ、15…種結晶、16…種ホルダ、17…ルツボ回転軸、18…単結晶育成装置。

【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 太田 友彦

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平
150番地 信越半導体株式会社半導体白河
研究所内

(72)発明者 布施川 泉

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平
150番地 信越半導体株式会社半導体白河
研究所内

(72)発明者 森 達生

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平
150番地 信越半導体株式会社半導体白河
研究所内

Fターム(参考) 4G077 AA02 BA04 CF10 EA02 EH09

EH10 HA12

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-226296

(43)Date of publication of application : 14.08.2002

)Int.Cl.

C30B 29/06

)Application number : 2001-024520

(71)Applicant : SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD

)Date of filing : 31.01.2001

(72)Inventor : SAKURADA MASAHIRO

MITAMURA NOBUAKI

OTA TOMOHIKO

FUSEGAWA IZUMI

MORI TATSUO

) METHOD FOR MANUFACTURING SILICON SINGLE CRYSTAL

)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing no defect silicon single crystal under a steady condition wherein at least defects such as OSF, FPD and LEP are not observed in the whole surface of a wafer which is obtained by slicing the grown silicon single crystal.

SOLUTION: The silicon single crystal by Czochralski method is manufactured under the condition that the crystal is grown in a region in which at least defects such as OSF, FPD and L/D are not observed in the whole surface of the sliced wafer of the crystal and the crystal is grown by controlling an average cooling rate to $\geq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ when the crystal passes through a temperature range wherein a void is formed by aggregation of vacancy pore defect.

LEGAL STATUS

ate of request for examination]

20.04.2004

ate of sending the examiner's decision of rejection]

nd of final disposal of application other than the
aminer's decision of rejection or application converted
gistration]

ate of final disposal for application]

atent number]

ate of registration]

umber of appeal against examiner's decision of
ection]

ate of requesting appeal against examiner's decision of
ection]

ate of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

NOTICES *

Our Patent Office is not responsible for any
 damages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
 *** shows the word which can not be translated.
 In the drawings, any words are not translated.

AIMS

aim(s)]

aim 1] When the raised silicon single crystal is sliced in the manufacture approach of the silicon single crystal by the
 Schrock method and it considers as a wafer While raising a crystal in the field in which OSF, FPD, and a ratio-of-
 length-to-diameter defect are not observed at least in the whole surface of a wafer The manufacture approach of the
 silicon single crystal characterized by controlling and raising so that the average of the cooling rate when passing the
 temperature zone in which a hole point defect condenses and a growth crystal forms a void defect may become more
 than 1 degree C / min.

aim 2] The manufacture approach of the silicon single crystal indicated to claim 1 characterized by making into
 10-1150 degrees C the temperature zone which forms the void defect which controls said pass time.

aim 3] It is the manufacture approach of the silicon single crystal indicated to claim 1 characterized by making into
 10-1050 degrees C the temperature zone which forms the void defect which controls said pass time when doping
 oxygen to a silicon single crystal.

aim 4] The silicon single crystal characterized by being raised by the approach given in any 1 term of claim 1 thru/or
 item 3.

translation done.]

OTICES *

an Patent Office is not responsible for any
ages caused by the use of this translation.

his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

*** shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

TAILED DESCRIPTION

tailed Description of the Invention]

01]

ld of the Invention] This invention relates to the approach of manufacturing a silicon single crystal with very few
with defects, such as OSF, FPD, and ratio of length to diameter, by the high yield, all over a wafer in silicon single
stal training by the Czochralski method.

02]

scription of the Prior Art] In recent years, the quality demand to the silicon single crystal produced with the
chralski method (it is hereafter written as a CZ process) used as the substrate has been increasing with detailed-izing
he component accompanying high integration of a semiconductor circuit. The defect of a single crystal growth
son in which the oxide film proof-pressure property especially called grown-in (Grown-in) defects, such as FPD,
FD, COP, and ratio of length to diameter, and the property of a device are worsened exists, and importance is
ched to reduction of the consistency and size.

03] In explaining these defects, it explains being known generally about the factor which determines each
centration of the point defect of the hole mold first called the Vacancy (it may outline Vacancy and Following V)
orporated by the silicon single crystal, and the mold silicon point defect between grids called Interstitial-Si (it may
line Interstitial-Si and Following I) incorporated.

04] In the silicon single crystal, V fields are Vacancy, i.e., the crevice generated from lack of a silicon atom, and a
d with many things like a hole, and the actual condition is called void-like defect of the octahedron which is the floc
hole. On the other hand, an I region is a field with many lumps of the rearrangement and the excessive silicon atom
ich are generated when a silicon atom exists too much, and the neutral (it may outline Neutral and Following N) field
hout lack of an atom or an excess (few) will exist between V field and an I region. And with [even if said grown-in
ects (FPD, LSTD, COP, ratio of length to diameter, etc.) occur when V and I are in a condition / *****/ to the last,
it has the bias of some atoms] saturation [below], it has turned out that it does not exist as a defect.

05] The concentration of both this point defect is decided from the pull-up rate (growth rate) of the crystal in a CZ
cess, and relation with the temperature gradient G near [under crystal] the solid-liquid interface. The defect called
F (an oxidation induction stacking fault, Oxidation Induced Stacking Fault) near [boundary] V field and an I region
en it sees in the cross section of the perpendicular direction to a crystal growth shaft, being distributed in the shape
a ring (it being hereafter called an OSF ring) is checked.

06] And a classification of the defect of these crystal growth reason calls V field the field where grown-in defects by
ich it is considered as the void reason to which hole type point defects gathered when a growth rate is a high speed
nparatively, the above before and after 0.6 mm/min and, such as FPD, LSTD, and COP, exist in high density
oughout the direction of the diameter of a crystal, for example, and these defects exist. Moreover, when a growth rate
0.6 or less mm/min, the field where an OSF ring is generated from the circumference of a crystal, the defect of ratios
length to diameter (Large Dislocation: the cable address of the dislocation loop between grids, LSEPD, LFPD, etc.)
sidered to be the dislocation loop reasons by the silicon between grids by the outside of this ring exists in a low
istency with the fall of a growth rate, and these defects exist is called the I region (it may be called a ratio-of-length-
diameter field). Furthermore, if a growth rate is made into a low speed below 0.4 mm/min order, an OSF ring will
dense and disappear at the core of a wafer, and the whole surface will serve as an I region. The defect in this I region
also called LEP (Large Etch Pit) and a rearrangement cluster.

07] Moreover, the existence of the field where neither FPD of a hole reason, LSTD, COP nor LSEPD of a
location loop reason and LFPD exist called N field to the outside of an OSF ring is discovered in the middle of V
d and an I region in recent years. It is reported that this field is the I region side which is not so rich as there is almost

precipitation of oxygen by being in the side of an OSF ring when oxygen precipitates on heat treatment is formed and the contrast of a deposit is checked by X-ray observation etc., and LSEPD and LFPD are formed.

08] Since these N fields existed aslant to growth shaft orientations by the usual approach when a growth rate is varied, they existed only in the part in the wafer side. About this N field, it has recited that a parameter called V/G which is the ratio of a pull-up rate (V) and a crystal solid-liquid interface shaft-orientations temperature gradient (G) determines the total concentration of a point defect by the Voronkov theory (V. V. Voronkov; Journal of Crystal Growth, (1982) 625-643). Only a crystal into which a core serves as an I region on the outskirts across N field in V field at a certain pull-up rate since it pulls up in a field, and the rate must be regularity and G has distribution in a field when it looks from this was obtained.

09] Then, distribution of G within a field was improved, and in this wafer side, when N field which existed only in part was pulled up lowering for example, the pull-up rate V gradually, the crystal with which N field spread all over. At a certain pull-up rate could be manufactured recently. Moreover, in order to expand the crystal of this whole surface N field in the die-length direction, if a pull-up rate when this N field spreads horizontally is maintained and pulled up, it can attain to some extent. Moreover, when adjusting the pull-up rate in consideration of G changing so that might be amended and V/G might become fixed to the last as the crystal grew, as it is, the crystal used as a whole surface N field could be expanded also in the growth direction.

10] However, when a single crystal was raised in this whole surface N field, that pull-up rate margin (control range) is very as narrow as $V \leq 0.02$ mm/min extent (J. G. Park and Japanese crystal growth society magazine vol. 27, 1990, pp14), the pull-up by which the grown-in defect was occurred and stabilized in fluctuation of few pull-up rates is difficult, the yield was low, and that improvement was desired.

11] On the other hand, if the above-mentioned N field is classified further, there is a nickel field (field with much concentration between grids) contiguous to Nv field (field with many holes) contiguous to the outside of an OSF ring and an I region, and in Nv field, when thermal oxidation processing is carried out, there are many amounts of precipitation of oxygen, and it has turned out that there is almost no precipitation of oxygen in nickel field.

12] [Problem(s) to be Solved by the Invention] Then, this invention was made in view of such a trouble, and when the raised silicon single crystal is sliced and it considers as a wafer, it aims at obtaining a defect-free silicon single crystal with which OSF, FPD, and a ratio-of-length-to-diameter defect are not observed at least in the whole surface of a wafer under manufacture condition stabilized more.

13] [Means for Solving the Problem] The manufacture approach of the silicon single crystal which it succeeded in order that the invention might attain said purpose, and is applied to this invention When the raised silicon single crystal is sliced the manufacture approach of the silicon single crystal by the Czochralski method and it considers as a wafer While raising a crystal in the field in which OSF, FPD, and a ratio-of-length-to-diameter defect are not observed at least in the whole surface of a wafer It is characterized by controlling and raising so that the average of the cooling rate when passing the temperature zone in which a hole point defect condenses and a growth crystal forms a void defect may become more than 1 degree C / min (claim 1).

14] Thus, while maintaining V/G value predetermined in the field in which OSF, FPD, and a ratio-of-length-to-diameter defect are not observed at least in the whole surface of a wafer and raising a crystal If the average cooling rate when passing the temperature zone which a hole point defect condenses and forms a void defect is quenched 1 degree C / above min N field or Nv field which exists in the outside of an OSF ring can be expanded, the margin of the pull-up rate of a crystal can be expanded sharply, and the effectiveness that the yield improves can be acquired.

15] In this case, it is desirable to make into 1080-1150 degrees C the temperature zone which forms the void defect which controls pass time (claim 2). Thus, if the 1080-1150-degree C temperature zone of a growth crystal is quenched, size of void defective floc will contract compared with annealing. When the average of a cooling rate is carried out for [in 70 or less minutes] for especially the pass time of this temperature zone 1 degree C / more than min, the size of void defective floc is very large, and the expansion effectiveness of N field when pulling up with the value of predetermined V/G is also large. Therefore, it is stabilized and a silicon single crystal without a crystal defect can be obtained.

16] Moreover, when doping nitrogen to a silicon single crystal, it is desirable to make into 990-1050 degrees C the temperature zone which forms said void defect (claim 3). Thus, when doping nitrogen to a silicon single crystal Since the temperature zone which forms said void defect shifts to 990-1050 degrees C from 1080-1150 degrees C when not doping nitrogen If the average cooling rate of the crystal in this temperature zone is carried out 1 degree C / more than min and is quenched, while N field when pulling up with the value of predetermined V/G will be expanded, the size of

d defective floc can contract remarkably compared with annealing, and a silicon single crystal without a crystal defect can be obtained.

17] Furthermore, according to this invention, the silicon single crystal characterized by being raised by said manufacture approach is offered (claim 4). When according to the manufacture approach of this invention the raised silicon single crystal is sliced and it considers as a wafer, the silicon single crystal with which OSF, FPD, and a ratio-of-length-to-diameter defect are not observed at least can be raised with the high yield under stable manufacture conditions on the whole surface of a wafer.

18] Hereafter, although explained to a detail per this invention, this invention is not limited to these. In advance of explanation, lessons is taken from each vocabulary, and it explains beforehand.

19] 2 Cr 2O₇ after cutting down a wafer from the silicon single crystal rod after growth and etching and removing a surface distortion layer with the mixed liquor of fluoric acid and a nitric acid in FPD (Flow Pattern Defect) A pit and a ripple pattern arise by etching a front face with the mixed liquor of fluoric acid and water (Secco etching). This ripple pattern is called FPD, and the defects of oxide-film pressure-proofing increase in number, so that the FPD consistency on a wafer side is high (refer to JP,4-192345,A).

20] 2) When the same Secco etching as FPD is performed, call SEPD (Secco Etch Pit Defect) a thing without FPD, a ripple, and a flow pattern for the thing accompanied by a flow pattern (flow pattern) with SEPD. When it is thought in this way, a large SEPD (LSEPD) 10 micrometers or more originates in a rearrangement cluster and a rearrangement cluster exists in a device, a current leaks through this rearrangement and it stops achieving the function as a P-N junction.

21] 3) Cut down a wafer from the silicon single crystal rod after growth, and carry out cleavage of the wafer to LSTD (Laser Scattering Tomography Defect) after etching and removing a surface distortion layer with the mixed liquor of fluoric acid and a nitric acid. Incidence of the infrared light can be carried out from this cleavage plane, and the defect scattering light which exists in a wafer can be detected by detecting the light which came out from the wafer front face. About the scatterer observed here, it is a society etc., there is already a report, and it is regarded as the oxygen defect (Jpn.J.Appl.Phys.Vol.32, P3679, 1993 reference). Moreover, the result that it is the void (hole) of octahedron is reported by the latest research.

22] 4) the defect which becomes the cause of degrading oxide film pressure-proofing of the core of a wafer, with COP (Crystal Originated Particle) -- it is -- Secco -- by SC-1 washing (washing by the mixed liquor of NH₄ OH:H₂O₂:H₂O=1:1:10), the defect set to FPD if dirty works as a selection etching reagent, and is set to COP. The diameter of a pit is investigated with light scattering measurement by 1 micrometer or less.

23] 5) It is the defect which there are LSEPD, LFPD, etc. in ratio of length to diameter (Large Dislocation: cable stress of the dislocation loop between grids), and is considered to be the dislocation loop reason by the silicon between grids. A large thing 10 micrometers or more is said that LSEPD described above also in SEPD. Moreover, also in FPD which LFPD described above, the magnitude of a tip pit says a large thing 10 micrometers or more, and it is considered dislocation loop reason also here.

24] [Embodiment of the Invention] this invention persons had remarkably few FPD(s), LSTD(s), and COP which are in the side of an OSF ring about the silicon single crystal growth by the CZ process in the middle of V field and an I region, and when a crystal was raised in neutral N field in which ratio of length to diameter does not exist, either, they remained expanding the range controllable to become in this field.

25] Although some variations are looked at by the report, the temperature zone in which a hole point defect forms is represented by 1080-1150 degrees C (). [KTakano] et al. and Mat.Sci. -- Forum196 and p -- 1707 and 1995; Walster et al. and Semiconductor Silicon 1998; The Electrochemical Society Proceeding Series and p -- 468 and 1998; Maishoji et al. and High Purity Silicon V and The Electrochemical Society Proceeding Series and p -- 28 and 1998.

26] If time amount to which a crystal passes this temperature zone is shortened, it is known that size will contract through grown-in defect consistencies resulting from a void, such as COP and FPD, increase (1707 KTakano et al., Mat.Sci. Forum196, p 1995). This was used, the size of the floc of a hole point defect was reduced by quenching, and it is conceived whether the range of the pull-up rate which can form N field of an OSF outside would be expandable.

27] Drawing 1 explains the example of a configuration of the single-crystal-growth equipment first used by this invention. The heater 7 for the single-crystal-growth equipment shown in drawing 1 to heat the crucibles 5 and 6 which had a raw material 4, for example, raw material melt, like common single-crystal-growth equipment, and a polycrystalline silicon raw material, and fuse etc. is stored in the Main chamber 1, it pulls up and the pull-up device (not shown) in which the raised single crystal which were formed successively on the Main chamber 1 is pulled up is placed in the upper part of a chamber 2. The single crystal rod 3 is formed under the seed crystal 17 by pulling up, the rod holder 18 for [which a wire 16 is beginning to be rolled and attaches seed crystal 17 at the tip] having been

ched in the upper part of the pull-up chamber 2 being connected, and the seed crystal 17 attached in the point of the holder 18 being immersed in raw material melt 4, pulling up a wire 16 from a device (un-illustrating), and rolling and according to a device.

27] In addition, the above-mentioned crucibles 5 and 6 consist of graphite crucibles 6 for supporting this quartz crucible 5 in the quartz crucible 5 which holds raw material melt 4 inside directly, and the outside. Crucibles 5 and 6 are supported by the crucible revolving shaft 19 in which a rotation vertical movement is free with the rotation drive (not shown) attached in the lower part of single-crystal-growth equipment 20, and in order to maintain a melt side at a fixed position so that crystal quality may not change by change of the melt side in single-crystal-growth equipment, only the position to which melt decreased according to the pull-up of the single crystal rod 3 is raising the crucible, rotating a crystal rod 3, and a hard flow.

28] The heating heater 7 is arranged so that crucibles 5 and 6 may be surrounded, and it is prepared in the outside of the heating heater 7 so that the heat insulation member 8 for preventing that the heat from a heater 7 is directly radiated to the Maine chamber may enclose a perimeter. Moreover, inert gas, such as argon gas, is introduced into a chamber 1 of the 2 interior from the gas inlet 10 established in the pull-up chamber 2 upper part for the purpose of discharging the side a furnace the impurity generated in the furnace etc., it passes through the single crystal rod 3 under raising, and melt 4 upper part, a chamber 1 and the 2 interior are circulated, and it is discharged from the effluence-of-gas outlet 9.

29] With the single-crystal-growth equipment used by this invention, in order to carry out forced cooling of the determined temperature zone which a hole point defect condenses the single crystal rod 3 under pull-up, and forms a void defect, even if there are few said Maine chambers 1 so that a cooling dome 11 may pull up and the inner single crystal rod 3 may be surrounded, it is extending toward a raw material melt front face from the head-lining section. At the same time, the upper limit of a cooling dome 11 may be pulled up according to the situation of installation, or the temperature distribution in a furnace, and may be extended in a chamber.

30] In the cooling dome 11 of the single-crystal-growth equipment 20 shown in drawing 1, a cooling medium is introduced from the cooling-medium inlet 12, and after this cooling medium circulates through the inside of a cooling dome 11 and carries out forced cooling of the cooling dome 11, it is discharged outside. In addition, although the liquid nitrogen is currently conventionally used as a cooling medium, it is suitable to use water in handling nature besides a cooling property, a cost side, etc. Moreover, if the flow rate and temperature of a cooling medium which are passed in these cooling domes 11 are adjusted if needed, since the heat extraction of a cooling dome can be changed, it is possible for this to control the cooling rate of a growth single crystal free.

31] Moreover, from said cooling dome 11, it extends caudad and has the cylinder or the cooling auxiliary member of a configuration whose diameter was reduced by going caudad. With the single-crystal-growth equipment 20 of drawing 1, the cooling auxiliary member 13 of the shape of a cylinder extended near the raw material melt side from the lower part of section of said cooling dome 11 is formed. The cooling auxiliary member 13 has surrounded the perimeter of the single crystal 3 immediately after the ability pulling up, and has the effectiveness which interrupts a heater 7 or the radiant heat from melt 4 grade, and cools a single crystal 3. Moreover, while it is prevented that a cooling dome 11 reaches to right above [of a melt side] and safety is secured, the rectification effectiveness of the inert gas which flows out the lower stream of a river of near the crystal from the melt upper part is demonstrated. The cooling rate of a growth crystal is controllable free also by adjusting spacing from the die length of this cooling auxiliary member 13, a diameter, the quality of the material, and a lower limit to a melt side etc.

32] The single-crystal-growth equipment 20 used by above this inventions By preparing combining a cooling dome and the cooling auxiliary member 13 as mentioned above First, the radiant heat from heater 7 grade is interrupted by the cooling auxiliary member 13, and the very hot single crystal 3 immediately after growing up from melt 4 is actively cooled. Since a cooling dome 11 is faced because it can pull up further, and it is cooled by the cooling dome to the head-lining section of the Maine chamber 1 at least, a crystal reaches far and wide and a single crystal 3 is led efficiently. Therefore, since the outflow heating value from a crystal is removed certainly and the cooling effect is demonstrated to the maximum extent, the temperature zone which a hole point defect condenses and forms void **** can be cooled quickly. Independently, by installing the magnet which is not illustrated in the horizontal outside of the Maine chamber 1, and impressing magnetic fields, such as a horizontal direction or a perpendicular direction, to silicon melt 4, the convection current of melt is controlled and, recently, the so-called MCZ method for measuring the stable growth of a single crystal is used in many cases.

33] (Experiment 1) MCZ possessing HZ (a hot zone, structure in a furnace) shown in above-mentioned drawing 1 -- single-crystal-growth equipment (horizontal magnetic field impression) was used, 150kg of raw material polycrystalline silicon was charged to the 24 inch quartz crucible, and the silicon single crystal of the diameter of 8

ies (diameter of 200mm) and bearing σ was pulled up.

34] First, by changing spacing of the tip of the cooling auxiliary member 13, and the surface of hot water, the amount of water of a cooling dome 11, etc., the growth crystal changed various time amount which passes a 1080-1150-degree C temperature zone, i.e., averages of a cooling rate, and grew up N field crystal. It asked for defective distribution and defective size about the wafer of the single crystal pulled up. Consequently, OSF, FPD, and ratio of length to diameter were not observed by the crystal which was able to be pulled up, but it checked into it that it was N field crystal of an OSF outside.

35] Next, when pulling up a single crystal using the above-mentioned equipment, the gradual decrease test controlled to windle a tail from a crystal head in the range of 0.7 mm/min to 0.3 mm/min, applying a growth rate was carried out, it asked for the relation of the time amount and growth rate margin ΔV which pass a 1080-1150-degree C temperature zone. ΔV is the growth rate V_{max} of the upper limit which OSF does not generate here. Growth rate V_{min} the minimum which ratio of length to diameter does not generate As a difference, it is $\Delta V = V_{max} - V_{min}$. It defines.

36] The above result is shown in drawing 2 (a). When it adjusts, it pulls up from drawing 2 (a) so that the conditions which form N field of an OSF outside for the pull-up growth rate V may be fulfilled and the time amount which passes 1080-1150 degrees C which is the temperature zone which forms a void defect is changed, it turns out that the margin of growth rate changes sharply and carries out sudden expansion in 70 or less minutes. The average cooling rates of the crystal at this time are more than 1 degree C / min. It is possible to mean attaining about 4 times as many ΔV as this V , in the case of quenching is compared with the case of annealing, and for manufacture of a defect-free field to become easy, and to increase the yield certainly. Moreover, V/G value which an OSF ring generates conventionally is made into the constant (W. vonAmmon et al., Journal of Crystal Growth, vol.151, p273, 1995; M.Hourai et al., Semiconductor Silicon 1998, The Electrochemical Society Proceeding Series, p453, 1998; JP,8-330316,A, etc.). However, it is suggested that V/G value changes with the cooling rates of a crystal in this experiment.

37] (Experiment 2) It asked for the relation of the time amount and the growth rate margin which pass 650-950 degrees C called temperature zone in which the oxygen between grids deposits by the same approach as experiment 1. The result is shown in drawing 2 (b). As this drawing shows, a correlation is weak and it turns out that it is not important for the cooling rate of a low-temperature field as an element to which a growth rate margin is expanded. In addition, although ΔV is carrying out sudden expansion in the field for about 500 minutes, if it is going to quench 650-1080 degrees C by about 500 minutes and will not quench 1150-1080 degrees C when it investigates, it will be thought that a pull-up of a crystal is impossible and it is the effect.

38] After being based on the knowledge acquired in the above experiment, this invention person etc. repeats the invention wholeheartedly and hits on an idea to this invention. In the manufacture approach of the silicon single crystal according [the manufacture approach of the silicon single crystal of this invention] to the Czochralski method when the raised silicon single crystal is sliced and it considers as a wafer, while raising a crystal in the field in which F, FPD, and a ratio-of-length-to-diameter defect are not observed at least in the whole surface of a wafer It is characterized by controlling and raising so that the average cooling rate when passing the temperature zone in which a point defect condenses and a crystal forms a void defect may become more than 1 degree C / min.

39]

NOTICES *

an Patent Office is not responsible for any
ages caused by the use of this translation.

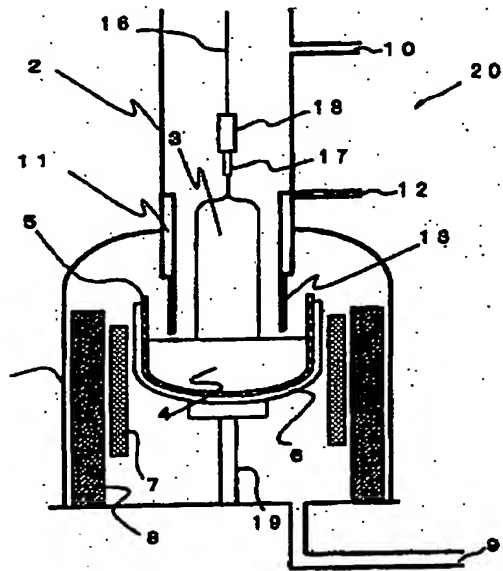
his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

** shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

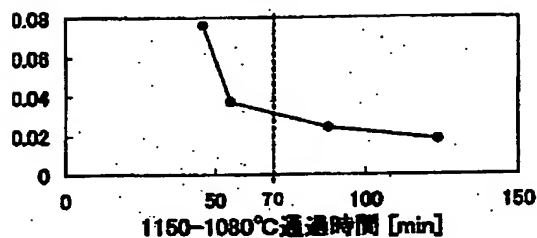
AWINGS

awing_1]

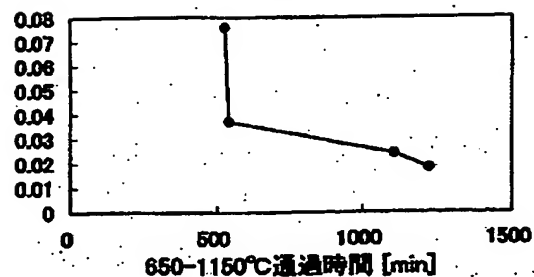


awing_2]

(a)



(b)



anslation done.]

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.